

e Edge Computing

2022年6月15日(水)～17日(金)
東京ビッグサイト東展示棟

[共催] 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
一般社団法人日本電子回路工業会

※電子機器トータルソリューション展2022と同時開催

申込受付開始!

2009年には10億台程度と言われているIoTデバイスは、2025年には400億台を超えるとの見通しが発表され、インターネットに接続されたデバイスが、膨大なデータを生成する時代が到来しています。そして、このデータを安定的に処理・分析・運用するため、今、「エッジコンピューティング」に注目が集まっています。

また、マーケットでは5Gの整備が進み、自動運転、スマート工場、遠隔医療、スマートシティなどの技術イノベーションが活況を

呈し、リアルタイムな分散処理が可能となるエッジコンピューティングへの期待が高まっています。

このような背景から、Smart Sensing展と同時開催し、センシングをベースとした「データ処理」「データ分析」「データ運用」にフォーカスし、低遅延・高信頼・通信量低減を実現する「Edge Computing」を開催することとしました。

開催概要

名称: Edge Computing 2022
会期: 2022年6月15日(水)～17日(金)
会場: 東京ビッグサイト東展示棟
共催: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
一般社団法人日本電子回路工業会
小間仕様: 1小間/9m²(3mx3m・スペースのみ)

出展料: 【通常価格】451,000円(税込)
【早期割引】360,800円(税込)
同時開催: 電子機器トータルソリューション展2022
(2021年開催実績:出展者数228社、出展小間数:411小間、
来場者数:16,699名)
早期申込締切: 2月18日(金)
最終申込締切: 3月11日(金)

電子機器トータルソリューション展2022とは

5G、自動車、IoT、ロボット、ウェアラブル、最先端光学システム等を具現化する技術を紹介する12展が集う総合展示会です。

JPCA Show
マイクロエレクトロニクスショー
JISSO PROTEC

SDGsデバイス展
WIRE Japan Show
Smart Sensing

JEP/TEP Show
E-Textile
interOpto

LED JAPAN
Imaging Japan
Edge Computing

出展対象: エッジソリューション

低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューションを提供する企業・団体

●エッジソリューション応用分野

自動運転システム、工場内機械制御、遠隔医療、AR/VR、スマートシティ、アグリテック、FinTech、無人店舗 等

●ハードウェアソリューション

CPU/MCU、FPGA、DSP、エッジデバイス、センサーソリューション、ネットワークソリューション

●ソフトウェアソリューション

OS、ミドルウェア、画像分析、音声分析、エッジAI、アプリケーション

●システムソリューション

各種システム、エッジセキュリティ

●プラットフォーム、開発ツール、インテグレーションサービス

来場対象

エレクトロニクス分野でも専門性の高い企業、研究団体の方が来場します。

自動車関連、OA/ロボティクス、情報・通信関連、AV・家電関連、医療機器関連、半導体デバイス関連、航空・宇宙関連、光技術、電子回路基板、その他

出展申込締切日: 2022年3月11日(金)

<https://edgecomputing.jp>



電子機器トータルソリューション展2022 構成展のご紹介

電子回路技術



第51回国際電子回路産業展

- プリント配線板技術展
製品(電子回路基板等の電子機器)、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム
- 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵に関する技術全般(製品/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
- フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
フレキシブルプリント配線板に関する技術全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)
- 機器・半導体受託生産システム展
EMS等の電子電気機器及び半導体に関する受託サービス全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会

高密度実装技術



第35回最先端実装技術・パッケージング展

実装・電子技術に関する技術全般(材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)

主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

電子部品実装技術



第23回実装プロセステクノロジー展

電子部品実装機及び関連機器/システム、半導体実装機/システム、検査/試験装置、実装設計システム

主催：一般社団法人ロボット工業会

SDGs 具現化技術



SDGsデバイス展

- ・再生可能エネルギー関連エレクトロニクス
- ・パワーエレクトロニクス関連 実装/材料
- ・パワー半導体/パワーデバイス(IGBT, MOSFET, パイボラトランジスタ、等)、各種メモリ(S-RAM, D-RAM、等)、半導体パッケージ、部品内蔵モジュール、メタルコアプリント配線板、熱ソリューション、太陽電池、バッテリー、水素燃料、パワエ、関連各種デバイス、他

共催：一般社団法人日本電子回路工業会

電子デバイス産業新聞(株)産業タイムズ社)

電気・光伝送技術



電気・光伝送技術展

ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部品/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等)

共催：一般社団法人日本電子回路工業会

電線新聞(株)工業通信)

半導体・電子部品



JEP 全国電子部品流通連合会

東京都電機卸商業協同組合

半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)

共催：一般社団法人日本電子回路工業会

全国電子部品流通連合会

東京都電機卸商業協同組合

高機能テキスタイル



イーテキスタイル展

電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)

共催：一般社団法人日本電子回路工業会

福井県e-テキスタイル製品開発研究会

センサー技術



スマートセンシング

センサー及びセンシングシステムに関する技術全般(センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)

共催：一般社団法人日本電子回路工業会

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

All about Photonics

光&次世代アプリケーション・ネットワークシステム

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION



インターオプト

レーザー・光源(半導体、ファイバ、超短パルス)/光学子部品(レンズ/フィルタ、ガラス、光スキャナ)/測定装置・光分析機器/生産向けレーザーシステム(レーザー加工装置、マーキング装置)/光情報通信(可視光通信、5G)

主催：一般財団法人光産業技術振興協会

企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

深紫外・近赤外・LED 応用開発



エールイーディージャパン

紫外・近赤外LED/LEDパッケージ部材/デバイス・電源/測定・検査・製造装置/光学部品・材料/LED応用最終製品(車載照明、LED可視光通信、医療用照明)

共催：一般社団法人日本電子回路工業会

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

画像処理・センシング技術



イメージングジャパン

各種カメラ・センサ機器/画像処理機器/画像認識・画像理解技術/計測・測定技術/LiDAR

共催：一般社団法人日本電子回路工業会

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

申込方法

右記の公式ホームページからお申込みください。

<https://edgecomputing.jp>



今後のスケジュール

2022年2月18日(金) 早期割引申込締切

2022年3月11日(金) 出展申込締切

2022年3月下旬 出展者マニュアルの公開

2022年4月上旬 出展者説明会(WEB)

2022年4月中旬

2022年6月13日(月)~14日(火)

2022年6月15日(水)~17日(金)

招待状配布(PDF予定)・

来場登録開始

搬入日

展示会会期

出展についてのお問合せ先